



機種名

PSX307

品番: NM-EFP1A



機種名	PSX307
品番	NM-EFP1A
クリーニング方式	高周波平行平板逆スパッタ方式
放電用ガス ^{*1}	アルゴンガス [オプション: 酸素]
基板寸法	L 50 mm X W 20 mm to L 250 mm X W ^{*2} 75 mm (Sタイプ搬送系とローダー/アンローダーのオプション付き) L 50 mm X W 20 mm to L 330 mm X W 120 mm (Mタイプ搬送系とローダー/アンローダーのオプション付き)
基板厚み	0.5 mm ~ 2.0 mm
設備寸法 / 質量 ^{*3}	W 930 mm X D 1 100 mm X 1 450 mm / 555 kg W 1 764 mm X D 1 100 mm X 1 450 mm / 850 kg (Sタイプ搬送系とローダー/アンローダーのオプション付き) W 1 764 mm X D 1 100 mm X 1 450 mm / 725 kg (Mタイプ搬送系とローダー/アンローダーのオプション付き)
電源 ^{*4}	単相 AC 200 V、2.00 kVA [ピーク時: 5.00 kVA]
空圧源	0.49 MPa以上、6.5 L / min [A. N. R.]

※詳細は、仕様書を参照願います。

^{*1} : 放電用ガスにオプションの酸素ガスを選択した場合、別途排気希釈用の窒素ガスも必要です。

^{*2} : W 70.1 mm ~ W 75 mmはチャンバー内電極が別途必要です。

^{*3} : 設備寸法の許容範囲は、±5mmです。タッチパネル、状況表示灯を除きます。質量は構成により異なります。

^{*4} : 単相 208 / 220 / 230 / 240 Vにも対応しています。

■ 極薄金メッキが使える理由

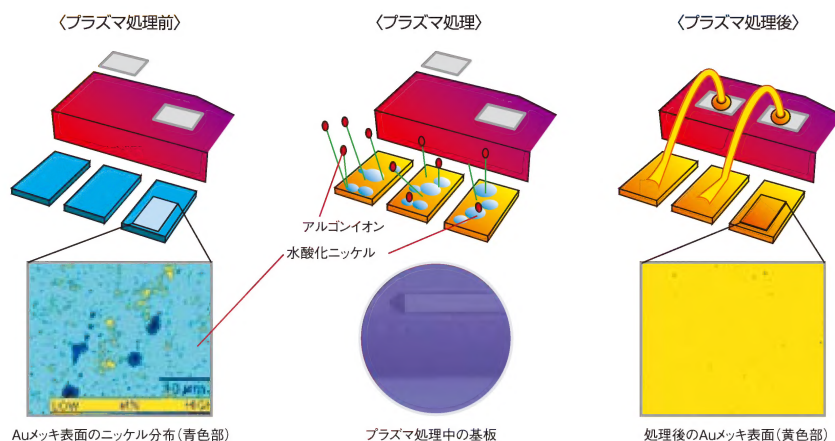
格安の極薄金メッキでは、ダイボンディングキュアの熱処理により、表面にニッケル化合物が形成されます。

このニッケル化合物は、ワイヤーボンディング性を阻害するために、従来薄金メッキはワイヤーボンディングに不向きとされてきました。

PSX307では、アルゴンプラズマ処理によりニッケル化合物を除去し、極薄の金メッキに安定したワイヤーボンディングを行なうことが可能です。

弊社製以外の装置において、下記特許(方法特許、製造物特許)を使用される場合には、パナソニック(株)との契約が必要です。

日本特許 2 783 133、2 783 260、3 000 877
英国特許 2 297 981
米国特許 5 647 942、5 767 008、6 331 347
独国特許 19 606 074



■ 酸素プラズマによる表面改質

酸素ラジカルを用いた表面改質により、モールド樹脂密着性、アンダーフィル濡れ性改善が可能です。【オプション】

